기술사 제 108 회

제 1 교시 (시험시간: 100분)

분	재료	조모	표면처리기술사	수험	성	
야	게표	8 7	표현시되기될까	번호	명	

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

- 1. 경질 크롬도금 생산 라인에서 제품 한 개 당 하나의 정류기를 사용하는 개별 정류기 방식을 활용할 때, 기대되는 효과를 4가지 설명하시오.
- 2. PCB 트루홀 도금(Through-Hole Plating)에서 사용하는 플르오르보레이트 욕 구리 도금 공정의 장점을 5가지 설명하시오.
- 3. PVD와 CVD 공정으로 DLC(Diamond Like Carbon) 코팅을 할 수 있는 방법을 3가지 설명하시오.
- 4. 무전해 니켈도금 공정은 외부 전원 장치를 사용하지 않아도 환원제의 자기 촉매 반응 (Auto-Catalytic Reaction)을 통하여 니켈 양이온을 소재 표면에 전착시킨다. 전착 반응의 원동력이 되는 자기 촉매 반응을 화학 반응식을 이용하여 설명하시오.
- 5. 양극산화에서 제품의 오목 부분이나 접촉부분 등에 남아있는 전해액을 중화시키기 위해 사용되는 약품명, 농도, 온도, 시간을 설명하시오.
- 6. 전착도장 공정에서 전처리부터 건조까지의 공정을 순서대로 설명하시오.
- 7. 아연이나 아연 다이캐스팅 제품을 음극 탈지할 때, 강알칼리가 음극면에 생기는 과정을 설명하시오.

기술사 제 108 회

제 1 교시 (시험시간: 100분)

분	재료	조모	표면처리기술사	수험	성	
야	게묘	8	표먼저리기술사	번호	퍵	

- 8. 수소취성이 발생했을 때, 수소취성 제거 방법을 설명하시오.
- 9. 국부적 부식 현상을 크게 대별하면 거시적 부식 현상과 미시적 부식 현상으로 분류 할 수 있다. 각각의 부식 현상에 대한 하위 부식 현상들을 구분하여 설명하시오.
- 10. 바렐도금에서 바렐의 회전수가 도금에 미치는 영향을 설명하시오.
- 11. 아연의 확산피복법(Sheradizing)을 설명하시오.
- 12. 음극반응과 양극반응에서 수소과전압의 특징 4가지를 설명하시오.
- 13. 탈지에 사용되는 계면활성제에서 표면장력과 계면장력을 설명하시오.

기술사 제 108 회 제 2 교시 (시험시간: 100분)

분	재료	조모	표면처리기술사	수험		성	
야	气压	7	표면저리기술사	번호	1	명	

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 이온 선택성 전극(Ion Selective Electrode : ISE)을 활용하여 전해질 용액 중의 활동도를 정량분석하고자 한다. 이온 선택성 분석 방법에서 기준 전극으로 사용할 수 있는 전극의 종류와 특징을 설명하시오.
- 2. 브러쉬 도금(Brush Plating) 정류기의 특성과 전기도금 공정에 사용하는 정류기의 특성을 비교하여 설명하시오.
- 3. 표면처리 내식성 시험방법 중 유공도 시험(Pin Hole Test)에 대하여 설명하고, 철, 구리합금 소지용 페록실 시험(Ferroxyl Test)액의 건욕 조건과 시험방법을 설명하시오.
- 4. 황산아연도금은 주로 못, 철선, 대강(帶鋼), 아연강판, 선재, 강재 등의 대규모 연속 도금 장치에 많이 이용되고 있다. 이 도금의 장점과 단점을 설명하시오.
- 5. 전해용액에서 전기도금(Electro Plating) 능력을 결정하는 요인 3가지를 열거하고, 설명하시오.
- 6. 스테인리스나 크롬을 함유한 니켈합금에서 나타나는 활성화 부동태 현상을 설명하시오.

기술사 제 108 회

제 3 교시 (시험시간: 100분)

분	재료	조모	표면처리기술사	수험	7	3
야	게표	8 7	표면처리기술사	번호	T	령

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 경질 크롬도금 층에서 금속 결정 구조가 마이크로 크랙(Micro Crack)에 미치는 영향을 설명하시오.
- 2. 음극 표면에 생성된 전기 이중층으로 금속 양이온이 공급되는 방식은 이온 영동, 대류 현상 및 확산 현상이다. 각각의 현상에 대하여 설명하시오.
- 3. 도금불량이 발생하는 도금액 중에 고형불순물(固形不純物)이 생성되는 요인과 혼입경로를 설명하시오.
- 4. 3중 니켈도금(Tri-Nickel Plating)에 대하여 설명하고, 부식 기구를 설명하시오.
- 5. 물리적 증착법 3가지를 설명하시오.
- 6. 플라스틱이나 무기질 재료에 직접 무전해 도금을 하는 경우의 일반적인 전처리법을 설명하시오.

기술사 제 108 회

제 4 교시 (시험시간: 100분)

분	재료	조모	표면처리기술사	수험	7	3
야	게표	8 7	표면처리기술사	번호	T	령

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 전기분해 과정에서 전해질 용액으로부터 발생하는 흄(Fume)과 미스트(Mist)는 작업자의 건강에 유해하다. 흄과 미스트에 대하여 정의하고, 발생되는 예를 설명하시오.
- 2. 수소취성(Hydrogen Embrittlement), 응력부식파괴(Stress Corrosion Cracking : SCC), 그리고 액체금속취화(Liquid Metal Embrittlement : LME) 현상을 구분하여 설명하시오.
- 3. 알루미늄 합금 제품에 도장 표면처리를 적용하고자 한다. 도장 밀착력을 향상시킬 수 있는 방법을 설명하시오.
- 4. 공식(Pitting)과 틈 부식(Crevice Corrosion)을 방지하기 위한 방법을 설명하시오.
- 5. 진공기술 실무에서 누설(Leak)의 발생원인 5가지를 설명하시오.
- 6. 동합금 소지위에 청화동 스트라이크도금을 한 결과, 도금표면이 벗겨지는 현상이 발견되었다. 도금이 벗겨지는 원인과 대책을 설명하시오.